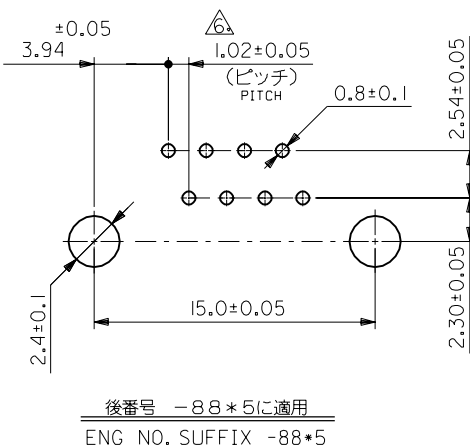
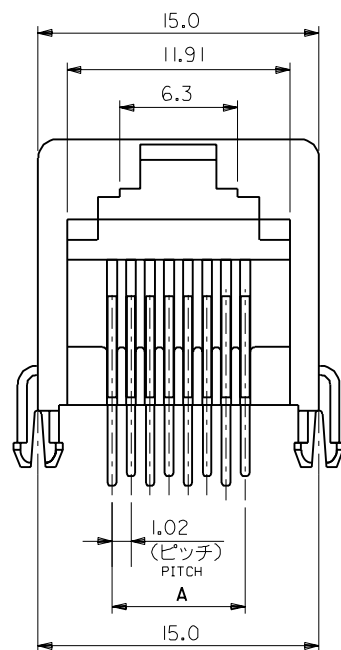
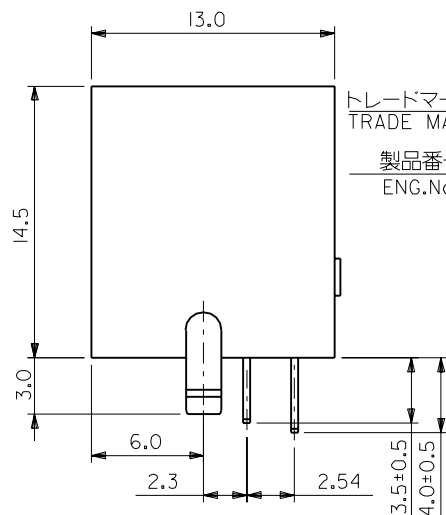
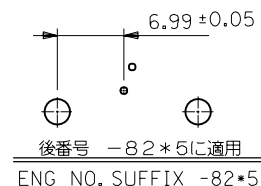
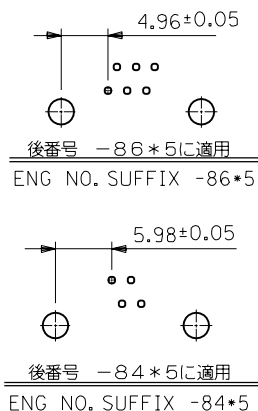




基板穴推奨寸法
RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
(ジャック取付け側)
(JACK ASS'Y SIDE)



トレードマーク
TRADE MARK
製品番号
ENG.No.



角度	ANGLE	±3°	B	変更 REVISED	(JC60607)	1/11	'96/3/8
30以上 OVER		+0.3	A	変更 REVISED	(T90386)	1/11	'89/2/8
10以上 30未満 OVER UNDER		+0.25	O	新規作成 RELEASED		1/11	'89/6/30
10未満 UNDER		+0.2	記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK. DATE	日付	
一般公差 GENERAL TOLERANCES			REVISE ONLY ON CAD SYSTEM				

材料 MATERIAL	注参照 SEE NOTES	仕上げ FINISH	注及び表参照 SEE NOTES AND CHART	適用電線範囲 WIRE RANGE	被覆外径 INS. RANGE	DRAWN BY '89/10/30 CHK'D BY '96/3/8 A. HIRAMOTO	尺度 SCALE 4 - 1
材料 MATERIAL	注参照 SEE NOTES	仕上げ FINISH	注及び表参照 SEE NOTES AND CHART	適用電線範囲 WIRE RANGE	被覆外径 INS. RANGE	DRAWN BY '89/10/30 CHK'D BY '96/3/8 A. HIRAMOTO	尺度 SCALE 4 - 1

注) NOTES

1. 材質 MATERIAL

ハウジング: ガラス入りポリエステル UL94V-0
HSG.: POLYESTER G.F.15% UL94V-0

ターミナル: リン青銅

TERM.: PHOSPHOR BRONZE

2. メッキ仕様 PLATING

接点部: 金メッキ、表参照

CONTACT AREA: GOLD PER TABLE

半田付け部: 半田メッキ 1.0 μmMIN.

SOLDER AREA: TIN-LEAD 1.0 μmMIN.

下地メッキ: ニッケルメッキ 1.0 μmMIN.

UNDERPLATE: NICKEL 1.0 μmMIN.

3. 推奨基板厚: t=1.6±0.05

RECOMMENDED P.C.B. THICKNESS: 1.6±0.05

△ 金メッキ厚標示

COLOR CODING TO INDICATE GOLD PLATING

黄色: 0.1 μmMIN. 緑色: 0.38 μmMIN.

YELLOW: 0.1 μmMIN. GREEN: 0.38 μmMIN.

オレンジ色: 0.76 μmMIN. 無色: 1.27 μmMIN.

ORANGE: 0.76 μmMIN. UNMARKED: 1.27 μmMIN.

5. ハウジングの色は、グレイ。

HOUSING COLOR IS GRAY.

△ 公差非累積。

NON-ACCUMULATIVE

8	8	7.11	1.27	52018-8845
			0.76	-8835
			0.38	-8825
			0.1	-8815
	6	5.08	1.27	-8645
ポジション POSITION	4	3.05	1.27	-8445
	2	1.02	1.27	52018-8245
	極数 CIRCUITS	(A)	金メッキ厚 (μmMIN.) GOLD PLATING THK(MIN.) (μmMIN.)	製品番号 ENG. No.

材料
MATERIAL

注参照
SEE NOTES

molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD.
日本モレックス株式会社

仕上げ
FINISH

注及び表参照
SEE NOTES AND CHART

EDP. NO.

適用電線範囲
WIRE RANGE

被覆外径
INS. RANGE

ENG. NO.

REV

適用電線範囲
WIRE RANGE

被覆外径
INS. RANGE

SD-52018-8**5

B

適用電線範囲
WIRE RANGE

被覆外径
INS. RANGE

TITLE 名称
MODULAR JACK
HOUSING ASS'Y